

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2025年3月1日至2025年3月13日)

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参会单位名单	1、3月1日 其他 华安基金、广发基金、国联基金、国联民生证券、华泰证券、华商基金、长信基金、弘悦私募、天风证券 2、3月13日 电话会议 中信证券 3、3月13日 现场调研 浙商证券、高致投资、金圆资本、盈怀基金、若川资本 (以上排名不分先后)
时间	2025年3月1日至2025年3月13日
地点	公司四楼会议室及线上等
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 马君
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司在新能源汽车领域的进展和战略布局如何？ 2024年年底，公司控股子公司芯动能第100万只车规级电驱双面散热封装模块成功下线，成为国内第二家拥有大规模量产车规级双面散热封装模块能力的半导体公司。该模块采用双面焊接、双面散热技术，封装形式兼容IGBT和SiC MOSFET芯片，同时在电学、热学特性及可靠性方面表现出色，能够满足200KW以内电机控制器的市场需求。

同时，公司 2024 年上半年推出的 GVD 模块（适用于增程式车型）及 800V 高压平台产品已批量交付，形成灌封与塑封模块双轨并行的产品结构。未来，公司将依托第七代 IGBT 技术迭代及 SiC MOSFET 芯片研发成果，深化与核心车企合作，积极拓展新兴客户，力求在车规产品市场中占据更大的份额。

本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。

2、公司 M7i 的性能如何？相较第六代有何先进之处？

公司围绕超微沟槽结构+场阻断技术、续流用软恢复二极管芯片技术等核心技术不断创新，产品全面覆盖新能源汽车、新能源发电、储能和工业控制需求，持续围绕微沟槽 IGBT 技术、虚拟原胞技术、逆导 IGBT 技术等多项第七代功率芯片关键技术进行创新，已实现关键性能指标对标国际先进水平，全面覆盖 650V/750V/1000V/1200V 电压等级，在新能源汽车电机控制器和新能源发电等领域实现规模化应用。相较 M6i，电流密度提升 20%，开关损耗降低 10%，最高工作温度达 175℃。

本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。

3、公司第三代半导体的技术突破与商业化进程如何？

宏微科技在持续迭代硅基功率器件产品的基础上，加速推进产业链延伸和产品布局。第三代半导体是公司战略布局的重点方向之一，公司已经在衬底、芯片、器件和模块等不同维度上进行了较为完整的技术布局。

近年来，公司第三代半导体取得了多项技术突破。在电动汽车领域，车规级 1200V SiC 自研模块正在研制中，对应的银烧结工艺已通过可靠性验证。在封装市场，SiC 混合模块已在新能源汽车、UPS 电源等领域应用。同时，1200V SiC MOSFET 芯片研制成功并已通过可靠性验证并实现小批量出货；自主研发的 SiC SBD（肖特基势垒二极管）芯片通过多家终端客户可靠性验证和系统级验证，部分产品已形成小批量出货。

此外，由公司控股并主导设立的子公司——上海宏微爱赛半导体有限公司于 2024 年 12 月正式成立，未来聚焦碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）以及高压大电流产品方向，联合科研机构探索高附加值场景，有望加速技术产业化进程。

本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。

	<p>4、近日公司在产业链协同方面的进展如何？</p> <p>2025 年年初，公司与华虹宏力签署为期五年的《战略合作谅解备忘录》，明确在 IGBT 与 FRD 等核心产品方面继续深入合作。双方通过联合成立研发项目组，共同致力于技术创新和平台优化，通过加强研发、优化工艺，在技术开发和市场拓展方面协同推进，共同推动市场竞争力提升，助力国内功率半导体产业链的完善。</p> <p>本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。</p> <p>5、如何看待功率器件在机器人行业的未来应用场景及发展空间</p> <p>功率器件是机器人高效运行的核心，主要应用于电机驱动、电源管理及热控制等环节。例如，工业机器人手臂依赖 IGBT 模块实现高扭矩输出，而协作机器人采用 GaN 器件缩小驱动器体积。未来，随着人形机器人产业化加速，第三代半导体渗透率将持续提升，功率器件有望成为智能化浪潮下的核心受益环节。目前，公司 IGBT 模块已应用于机器人场景，但营收占比较小，未来将结合 SiC/GaN 技术优势，适时加大在热管理、电源管理等环节的投入，进一步拓展新兴应用场景。</p> <p>本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。</p>
<p style="text-align: center;">说明</p>	<p>1、接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。前来公司现场调研的投资者均已签署《调研承诺书》。</p> <p>2、本记录表未列出部分与前期投资者活动重复的问题和回复，详情可查阅公司前期披露的投资者关系活动记录表。</p> <p>3、本次活动不涉及应当披露重大信息，不构成任何投资建议，本记录表涉及的具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。</p>